

自社販売への切り替えでサービス体制を強化するDISCO

迪思科高科技股份有限公司は、半導体ウェハの精密加工装置世界大手である株式会社ディスコの台湾現地法人として2007年に設立された。「切る」「削る」「磨く」の分野に特化し、世界シェアの7割を占める。台湾では、2015年の3月末の代理店契約満了に伴い、代理店を通じた販売体制から自社販売へと大きく舵を切り、サービスエンジニア人材の増強や自社物流倉庫の確保など、積極的な事業展開を行っている。今回は迪思科高科技股份有限公司の黒瀬副総経理を訪ね、台湾の半導体設備市場の現況や、今後の事業展開についてお話を伺った。



迪思科高科技股份有限公司 黒瀬康令副総経理

—台湾進出の経緯について

迪思科高科技股份有限公司（以下、当社）は、2007年に株式会社ディスコの100%子会社として設立されました。拠点を設けたのは2007年ですが、台湾事業自体は、1970年代の台湾半導体産業創成期にスタートし、台湾の代理店を通して製品の販売・アフターサービスを行っていました。

その後、台湾半導体産業が成長するに伴い、ユーザのニーズも複雑化し、迅速かつ適切なユーザ対応を行う必要性が増し、台湾に拠点を設けるに至りました。進出当初は、営業、アフターサービスを台湾の代理店が主に担当し、当社はその営業支援を行っていました。

—台湾拠点の事業内容について

台湾には、新北市新店の本社、新竹、台中、台南、高雄の計5拠点を構えています。新北市の本社には、ユーザが当社の製品を用いてテストカット等ができる施設、アプリケーションラボラトリー（クラス10,000のクリーンルーム）を設けています。

当社の事業内容は、今年から大きく変化しています。今年の3月31日に台湾パートナーとの代理店契約が満了し、4月1日から当社が台湾事業での営業及びアプリケーション、アフターサービス、消耗品、メンテナンスパーツの在庫・販売まですべて自社で実施する体制に切り替わりました。以前より大型ユーザから迅速な対応のため直接取引をしたいとのリクエストを頂いていたこと、また市場のニーズを的確に把握し対応するために、このような体制をとることになりました。

業務範囲拡大に合わせて従業員の採用を進め、ここ3年間で、約2倍（200名程）まで規模が拡大しています。特に、アフターサービスの充実に欠かせないサービスエンジニアの強化に注力しました。また、消耗品、メンテナンスパーツの在庫を確保するため、桃園に新しく自社倉庫を設け、ユーザの保守要望に素早く対応できる体制を整えました。

その他の業務として、このアプリケーションラボラトリーの設備を活用して、台湾の研究機関や大手ユーザの技術開発サポートを行っています。自社製品の開発・生産については、すべて日本国内で実施しています。

—台湾半導体設備市場の状況

直近2年間の台湾半導体市場は、スマートフォンの需要拡大、ウェアラブルデバイスの登場などで好調に推移しており、それに伴い半導体製造大手の活発な設備投資がありました。当社は製品によってもばらつきがありますが、グローバル市場でのシェアと同様、台湾でも7-8割程のマーケットシェアを獲得しています。当社の半導体向けの設備は、世界大手のユーザが多く、先端技術を用いた最高加工精度の製品で対応しており、競合製品と比較して品質において優位性を維持しています。主力製品であるダイシングソーやレーザーソーについては、日本を始め、欧米系の競合が数社いますが、現時点では地場メーカーとは競合にはなっていません。

一方、一般照明向けLED向けの設備など、半導体と比べて加工精度が求められる製品については、中国メーカーや韓国のメーカーなどが台頭してきており、激しい価格競争が始まっ

日本企業から見た台湾

ています。ただし、製造装置事業は、製品の競争力だけでなく、加工ソリューション・アフターサービスなど非製品競争力も求められるため、総合的な評価により当社の製品が選ばれています。

貴社の強みについて

当社は、製品とサービスとの両面の強みを持ち合わせています。「切る」「削る」「磨く」の分野に特化しており、そのキーマジックである砥石についても独自で開発・生産しています。砥石と装置の両方を長年手掛け、これまで培った加工ノウハウを提供できる装置メーカーは当社だけだと自負しています。

我々の装置及び加工ツールは、ユーザによってカスタマイズが必要であり、特に半導体メーカーの要求精度が高まると共に、その精度を達成するために砥石と装置とのバランスをとりながら調整することが必要になります。その両方の技術を持ち合わせ、ユーザのニーズに合った加工精度の高いソリューションを提案できることが当社の強みの一つとなっています。

また、完全日本生産を行うことで製品の開発スピード及び品質を保っています。数年前までは円高が続いており、多くの機械メーカーが海外生産に乗り出しましたが、当社は日本生産にこだわっています。日本ですべての製品開発を実施し、サプライヤも日本国内に集積していますので、現時点では品質面でもコスト面でも日本で集中的に生産することが効率的だと判断しています。

前述の通り、非製品の競争力も設備事業では重要視されます。その点について、当社でも重点的に強化しています。当社の200名の従業員の内、半数の100名はエンジニアです。メンテナンスサービス担当のカスタマーエンジニアと加工検証を担当するアプリケーションエンジニアを重点的に増強することで、ユーザに対して迅速に対応できる体制を整えています。また、日本と同じ内容のユーザアンケートを毎年実施し、満足度の低かったユーザに対して、改善の提案を行うなどの取り組みも地道に行っています。

今後の事業展開について

半導体市場は今後も継続的に拡大していくと考えています。特に半導体のアプリケーションがB2C向けではスマート

フォンからウェアラブル端末に広がり、B2B向けでもIoTが製造業にまで浸透していく中で、半導体ニーズは引き続き拡大していきます。その半導体の一大生産拠点である台湾で、ユーザのニーズに迅速に対応する体制を強化していきたいと考えています。特に、販売代理店の契約満了に伴う商流の変化に、きちんと対応していくことが短期的な目標です。

また、引き続き台湾での人材育成及び企業文化(DISCO VALUES)の醸成にも力を入れていきたいと考えています。その取り組みの一つとして、数名のエンジニアを日本へ逆出向させ、3年間トレーニングを行ってきました。今年出向から戻ったエンジニアが、技術サポートだけでなくDISCO VALUESの台湾拠点への更なる浸透に中心的な役割を担っていくことを期待しています。

その他にも、日本本社で2011年末に導入された「個人Will(ウィル)会計」(社員一人ひとりが毎月の収入と支出を仮想通貨で管理する制度)について、台湾でも導入が開始されています。個人レベルで採算を意識した経営を台湾拠点にも導入することで、コストと効率を両立した組織に育ってきました。

これらの取り組みを通して、ユーザへの対応だけでなく、社内体制の充実を追求しながら、台湾事業をさらに活性化していきたいと考えています。

ありがとうございました。

迪思科高科技(股)有限公司の基本データ

会社名	迪思科高科技股份有限公司
董事長	関家 一馬
設立	2007年
従業員	約200名
事業内容	・精密加工装置、精密加工ツール、 関連機器の販売および保守点検 ・テストカットサポート

注)2015年5月時点のデータによる
出所)公開資料及びヒアリングよりNRI整理